

# 信用等级通知书

东方金诚债跟踪评字【2026】0082号

常州银河世纪微电子股份有限公司：

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及“银微转债”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为  $A^{+}_{sti}$ ，评级展望为稳定，同时维持“银微转债”信用等级为  $A^{+}_{stio}$ 。

东方金诚国际信用评估有限公司

信评委主任

二〇二六年六月十五日

## 信用评级报告声明

为正确理解和使用东方金诚国际信用评级有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：

1. 本次评级为委托评级。东方金诚及本次评级人员与委托方、受评对象不存在任何影响本次评级行为独立性的关联关系，并依据相关法律法规、监管规定、公司评级流程及评级标准做出独立判断，未受任何机构或个人的干预和影响。
2. 本报告所引用资料及外部专业意见的合法性、真实性、准确性、完整性由资料及外部专业意见的提供方和/或发布方负责，东方金诚引用资料及外部专业意见不应视为东方金诚对该资料及外部专业意见合法性、真实性、准确性及完整性做出了任何形式的保证，也不承担该资料及外部专业意见导致的任何责任。
3. 本报告所含评级结论及相关分析为东方金诚基于相关信息和资料对受评对象信用状况所发表的预测性观点，而非对受评对象的事实陈述或鉴证意见。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在一定局限性。
4. 本报告所含评级结论及相关分析仅为东方金诚对受评对象信用状况的个体意见，不构成任何投资或财务建议，并且不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。东方金诚不对任何机构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责，亦不对评级委托方、受评对象使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。
5. 本次债项评级结果原则上自本报告出具之日起在债项剩余存续期内有效，东方金诚有权另行发布跟踪评级结果或评级结果变更公告（调整、撤销、终止等）。
6. 本次信用评级结果仅适用于本次（期）债券，未经东方金诚书面同意，本报告及评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。东方金诚对本报告未经授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任并保留追偿权利。
7. 本报告知识产权归东方金诚所有。未经东方金诚书面授权，严禁以任何形式/方式复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。
8. 任何机构或个人使用本报告均视为已经充分阅读、理解并同意本声明所列全部条款。

东方金诚国际信用评级有限公司

2026年6月15日

常州银河世纪微电子股份有限公司  
主体及“银微转债”2026年度跟踪评级报告

主体信用跟踪评级结果 <sup>1</sup>	跟踪评级日期	上次评级结果	评级组长	小组成员
A+ <sub>stf</sub> /稳定	2026/6/15	A+/稳定	乔艳阳	韩家麒

债项信用			评级模型			
债项简称	跟踪评级结果	上次评级结果	一级指标	二级指标	权重(%)	得分
银微转债	A+ <sub>stf</sub>	A+	企业规模	营业收入	15.00	7.13
注：相关债项详细信息及其历史评级信息请见后文“本次跟踪相关债项情况”。			市场竞争力	产品竞争力	10.00	5.00
				技术及研发实力	10.00	5.00
主体概况			盈利能力和运营效率	竞争壁垒	10.00	3.00
				成长性	5.00	4.00
				净利润	10.00	5.03
跟踪期内，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）仍主要从事小信号器件、功率器件等半导体分立器件产品的生产、销售，控股股东仍为常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”），实际控制人仍为自然人杨森茂。			债务负担与保障程度	毛利率	10.00	7.03
				总资产周转率	5.00	4.18
			调整因素	资产负债率	15.00	12.23
				经营现金流负债比	10.00	6.62
			个体信用状况		无	
			外部支持		无	
			评级模型结果		A+	
注：最终评级结果由信评委参考评级模型输出结果通过投票评定，可能与评级模型输出结果存在差异。						

## 评级观点

公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售，具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力，跟踪期内仍具有一定细分市场竞争力；研发方面公司完成6英寸平面高速开关芯片批量量产，车用SiC功率器件研发取得阶段性突破，2025年新获得发明专利2项，研发费用0.62亿元，同比增加10.10%，仍保持较强技术实力；公司围绕汽车电子、储能等行业，加大大客户开发力度，导入天马微、安斯泰莫、南都电源等客户，进入沃尔沃亚太国产白名单，巩固了在汽车电子领域市场地位；2025年，下游终端市场产品景气度提升，公司MOS产品、TVS及稳压管产品销售规模扩大，同时在车规级半导体产业化项目推进下，车规级产品产销规模持续扩大，带动营业收入及毛利润增长。

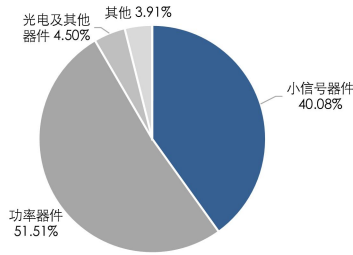
但同时，半导体分立器件领域技术更迭较快，下游客户需求不断升级、行业产品迭代仍将使公司面临技术升级挑战；2025年，应收账款及存货对资金占用增加，经营性现金流净流入规模有所下降；公司在建项目后续投资规模仍较大，外部环境变化或将使公司面临投资回报不及预期的风险。

综合分析，东方金城维持公司主体信用等级为A+<sub>stf</sub>，评级展望为稳定，维持“银微转债”的信用等级为A+<sub>stf</sub>。

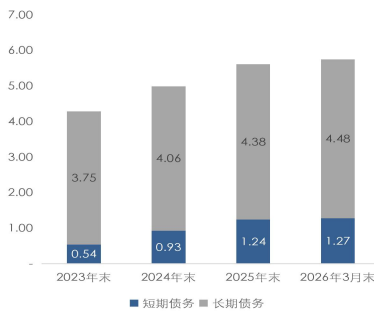
<sup>1</sup> 该主体信用等级及评级展望在2027年6月14日内有效，期间如有评级调整则以最新调整为准。

## 主要指标及依据

### 2025 年公司营业收入构成



### 债务结构 (单位: 亿元)



### 主要数据和指标

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 3 月
资产总额 (亿元)	19.90	22.06	23.34	23.54
所有者权益 (亿元)	13.21	13.65	14.14	14.33
全部债务 (亿元)	4.29	4.99	5.61	5.75
营业总收入 (亿元)	6.95	9.09	10.50	2.67
利润总额 (亿元)	0.69	0.75	0.78	0.18
经营性净现金流 (亿元)	1.02	0.67	0.44	0.25
营业利润率 (%)	25.80	25.62	24.64	23.78
资产负债率 (%)	33.60	38.10	39.42	39.13
流动比率 (%)	644.76	443.90	390.82	406.67
全部债务/EBITDA (倍)	2.76	2.90	2.93	-
EBITDA 利息倍数 (倍)	4.73	4.83	4.95	-

注: 数据来源于公司 2023 年~2025 年经审计的合并财务报告及 2026 年 1~3 月未经审计的合并财务报表。

## 优势

- 公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售, 具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力, 跟踪期内仍具有一定细分市场竞争力;
- 跟踪期内, 公司研发方面持续增加投资力度, 完成 6 英寸平面高速开关芯片批量量产, 车用 SiC 功率器件研发取得阶段性突破, 2025 年新获得发明专利 2 项, 研发费用 0.62 亿元, 同比增加 10.10%, 仍保持较强技术实力;
- 跟踪期内, 公司围绕汽车电子、储能等行业, 加大大客户开发力度, 导入天马微、安斯泰莫、南都电源等客户, 进入沃尔沃亚太国产白名单, 巩固了在汽车电子领域市场地位;
- 2025 年, 下游终端市场产品景气度提升, 公司 MOS 产品、TVS 及稳压管产品销售规模扩大, 同时在车规级半导体产业化项目推进下, 车规级产品产销规模持续扩大, 带动营业收入及毛利润增长。

## 关注

- 半导体分立器件领域技术更迭较快, 下游客户需求不断升级、行业产品迭代仍将使公司面临技术升级挑战;
- 跟踪期内, 公司应收账款及存货对资金占用增加;
- 公司在建项目后续投资规模仍较大, 外部环境变化或将使公司面临投资回报不及预期的风险。

## 评级展望

公司评级展望为稳定。未来, 随着国产替代的加速进行以及汽车电子、工业控制领域需求的增长, 预计公司仍将保持在小信号及功率器件领域较强的市场竞争力。

## 评级方法及模型

半导体企业信用评级方法及模型 (RTFC027202504)

## 历史评级信息

主体信用等级	债项信用等级	评级时间	项目组	评级方法及模型	评级报告
A+/稳定	A+	2025/6/18	宋馨、乔艳阳	《半导体企业信用评级方法及模型》 (RTFC027202504)	阅读原文
A+/稳定	A+	2021/12/16	高君子、宋馨	《信息技术企业信用评级方法及模型》 (RTFC012202004)	阅读原文

注: 自 2021 年 12 月 16 日 (首次评级) 以来, 银河微电主体信用等级未发生变化, 均为 A+/稳定。

### 本次跟踪相关债项情况

债项简称	上次评级日期	发行金额(亿元)	存续期	增信措施	增信方/主体信用等级/评级展望
银微转债	2025/6/18	5.00	2022.07.04~ 2028.07.03	无	无

## 跟踪评级原因

根据相关监管要求及常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）相关债项的跟踪评级安排，东方金诚国际信用评级有限公司（以下简称“东方金诚”）进行本次定期跟踪评级。

## 主体概况

**跟踪期内，公司仍主要从事小信号器件、功率器件等半导体分立器件的生产、销售，实际控制人仍为自然人杨森茂**

跟踪期内，银河微电仍主要从事小信号器件、功率器件等半导体分立器件的生产、销售，截至 2026 年 3 月末，公司股本 1.29 亿股，控股股东仍为常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”），持股比例为 31.61%，实际控制人仍为自然人杨森茂。

公司主营半导体分立器件制造业务，产品包括小信号器件、功率器件等，掌握多个门类、多种封装外形产品的设计技术和制造工艺。公司在半导体分立器件封装测试领域拥有多年经验积累，并向上游器件设计、芯片制造等领域延伸，掌握高密度阵列式框架设计技术、点胶量 CPK 自动测量控制技术等半导体分立器件封装测试技术，以及平面结构芯片无环高耐压终端技术、平面结构功率稳压二极管、TVS 芯片设计及制备技术等功率二极管芯片制造技术，截至 2025 年末，公司累计拥有有效专利 220 项，其中发明专利 42 项，实用新型专利 172 个。

截至 2026 年 3 月末，公司资产总额 23.54 亿元，所有者权益 14.33 亿元，资产负债率为 39.13%。2025 年和 2026 年 1~3 月，公司分别实现营业收入 10.50 亿元和 2.67 亿元，分别实现利润总额 0.78 亿元和 0.18 亿元。

## 债券本息兑付及募集资金使用情况

“银微转债”募集资金总额 5.00 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额 4.91 亿元。截至 2026 年 3 月末，累计投入“车规级半导体器件产业化项目”资金金额为 3.64 亿元，目前“车规级半导体器件产业化项目”已投资完成并达到预定可使用状态；剩余资金公司拟全部用于补充流动资金，截至 2026 年 3 月末，已用于补充流动资金金额为 0.89 亿元。

截至本报告出具日，“银微转债”按时支付利息，尚未到还本日。

截至 2026 年 3 月 31 日，“银微转债”累计共有 284000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 8899 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0069%。

## 宏观经济和政策环境

**受出口高增、投资止跌回升带动，一季度经济增长动能增强，物价水平偏低局面也在改善**

2026 年一季度 GDP 同比增长 5.0%，增速较上季度回升 0.5 个百分点。主要原因是在外需

偏强，以及国内制造业转型升级效应显现，推动芯片、新能源汽车等高新技术产品出口高增，当季出口增速明显加快，以美元计价同比增长 14.7%，显著高于去年四季度的 3.8%。一季度工业生产同比增长 6.1%，增速比上季度加快 1.1 个百分点。另外，一季度在基建投资快速增长带动下，固定资产投资同比增长 1.7%，对一季度 GDP 增速加快起到了一定推动作用。最后，在国内市场竞争秩序不断优化，以及国际大宗商品及芯片价格较快上涨综合作用下，一季度物价水平偏低状况也有明显改善，衡量宏观经济整体物价水平的 GDP 平减指数同比降幅由去年四季度的-0.65%收窄至-0.06%，二季度将会转正。需要强调的是，一季度高技术制造业增加值同比增长 12.5%，比去年全年增速加快 3.1 个百分点，明显领先整体工业生产增速，显示新质生产力领域快速发展对经济增长的拉动力在进一步增强。

展望二季度，GDP 增速有望达到 4.8%左右，较一季度会略有放缓，主要原因是受中东地区地缘政治冲突拖累全球经济，以及去年同期基数偏高等影响，二季度出口增速有可能放缓。总体上看，未来一段时间宏观经济运行将以稳为主，投资还有提速空间，居民消费会温和增长，房地产市场调整幅度有望收敛。

### 短期内宏观政策将继续处于观察期，降息降准会进一步后移；下半年财政政策有加码空间

短期来看，外部地缘政治冲突对国内物价的推升效应已经显现，对经济增长动能的扰动还要进一步观察。在物价水平上升、出口保持较快增长的预期下，二季度宏观政策还将保持较强定力。其中，降息降准会进一步后移，央行将主要通过结构性政策工具，引导金融资源重点流向科技型企业 and 中小微企业，着力推动新旧动能转换，稳定就业大局，同时坚持不搞大水漫灌。今年目标财政赤字率、新增专项债、新增超长期特别国债规模均与上年持平，同时设立 8000 亿元新型政策性金融工具。这意味着今年财政政策将主要通过准财政工具发力，重点是扩投资，促消费的重点正在从商品消费转向服务消费。我们判断，下半年财政政策有灵活加码空间。

### 行业分析

跟踪期内，公司营业收入仍主要来源于小信号器件、功率器件等半导体分立器件的生产、销售，属于半导体分立器件制造行业。

**半导体分立器件广泛应用于计算机及其周边设备、家用电器等传统领域和汽车电子、5G 等新兴领域，随着新兴领域的需求增长及国产化替代加速，国内市场韧性显著**

半导体分立器件是指具有单独功能且功能不能拆分的电子器件，主要功能为实现各类电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等，具有广泛的应用范围和不可替代性，是半导体产业的基础及核心领域之一。半导体分立器件产品包括小信号器件（小信号二极管、小信号三极管）和功率器件（功率二极管、功率三极管、桥式整流器）等，下游应用领域主要包括计算机及其周边设备、家用电器等传统领域及汽车电子、新能源发电和 5G 等新兴领域。

2025 年，全球半导体市场逐步走出周期性波动呈现复苏态势，根据 WSTS 的数据，2025 年全球分立器件市场规模回升至 352 亿美元。同时，中国市场仍保持向好发展态势，核心驱动力包括新能源汽车、储能、5G 通信、工业自动化等新兴领域的需求增长以及国产化替代加速。



图表 2：近年我国集成电路产业相关产业政策

时间	发布单位	文件名称	相关内容
2025 年	国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局	《关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	明确清单涵盖的集成电路企业/项目范围，重点集成电路设计企业，集成电路关键原材料、零配件生产企业等；列入清单的企业可享受企业所得税减免、研发费用加计扣除、进口环节关税优惠等政策，同时明确监管要求，规范企业申报行为，确保优惠政策精准落地，降低企业研发与经营成本
2024 年	工业和信息化部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用；加快突破 GPU 芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术，建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。
2023 年	工业和信息化部、财政部	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	提升产业链现代化水平。聚集集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。
2022 年	深圳市发展和改革委员会	《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025 年）》	到 2025 年，集成电路产业能级明显提升，产业结构更加合理，建成具有影响力的半导体与集成电路产业集群，产业规模大幅增长，制造、封测等关键环节达到国内领先水平，产业链联动协同进一步加强，自主创新能力进一步提升。

资料来源：中商产业研究院、东方金城整理

## 业务运营

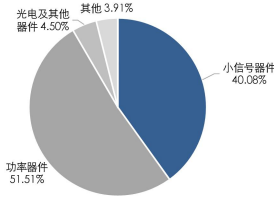
### 经营概况

公司营业收入和毛利润仍主要来源于小信号器件、功率器件生产和销售，跟踪期内，营业收入、毛利润同比增长，综合毛利率小幅下降

跟踪期内，公司仍主营小信号器件、功率器件等半导体分立器件的生产和销售，并涉及光电器件及其他器件等，小信号器件、功率器件销售收入合计占比仍在 90%以上，是公司主要收入和毛利润来源。2025 年，公司继续调整产品结构，功率器件的收入占比提升至 51.51%，小信号器件的收入占比 40.08%。受益于下游终端市场产品景气度提升，同时公司加大客户拓展力度，带动公司营业收入和毛利润均同比进一步增长；受小信号器件产品毛利率下降的影响，公司综合毛利率小幅下降。

图表 3：公司营业收入构成及毛利润、毛利率情况（亿元、%）

类别	2023 年		2024 年		2025 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
小信号器件	3.31	47.60	4.00	44.04	4.21	40.08
功率器件	3.17	45.60	4.42	48.59	5.41	51.51
光电及其他器件	0.27	3.94	0.31	3.45	0.47	4.50
其他	0.20	2.86	0.36	3.92	0.41	3.91
合计	6.95	100.00	9.09	100.00	10.50	100.00
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
小信号器件	1.05	31.66	1.23	30.76	1.13	26.91
功率器件	0.67	21.26	1.09	24.67	1.36	25.22
光电及其他器件	0.07	24.34	-0.02	-5.85	0.00	0.96
其他	0.05	26.63	0.08	22.67	0.14	33.75
合计	1.84	26.49	2.38	26.22	2.64	25.14



资料来源：公司提供，东方金城整理

### 小信号及功率器件制造

公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售，跟踪期内持续推进 IGBT、SiC MOSFET 等新产品布局，获得多家车企供应链认证，同时光电耦合器及 LED 产品实现工业自动化、医疗设备等领域应用，仍具有一定细分市场竞争力

公司主要从事小信号、功率器件等半导体分立器件研发、生产和销售，小信号及功率器件产业链涉及器件设计、晶圆和芯片设计制造、封装测试三个主要环节。公司目前的产品涵盖小信号器件、功率器件、光电器件及其他电子器件，以封装测试专业技术为基础，逐步拓展部分功率二极管芯片的设计和制造能力、MOSFET 等芯片的设计能力，具备一定器件一体化设计及生产整合能力。同时，公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队，依托丰富的产品种类和专业化的技术支持，为客户提供一站式采购服务。在新产业布局方面，跟踪期内，公司“车规级半导体器件产业化”项目已投资完成并达到预定可使用状态，产品涵盖 IGBT、SiC MOSFET 等。公司车规级产品的设计生产过程严格遵循 IATF16949 质量管理体系标准，性能和可靠性符合 AEC-Q101 车规试验验证，产品已广泛应用于车身控制、智能驾舱、车载照明、BMS 等领域，并与多家国内外汽车零部件头部企业建立了合作关系。此外，公司继续推进车用 LED 灯珠、光电耦合器等光电器件、电源管理 IC 及第三代半导体器件的产业化落地，产品应用于汽车电子、人工智能、能源动力、工业自动化、计算机与周边、网络通讯、家用电器等领域。整体来看，公司仍具有一定细分市场竞争力。

跟踪期内，公司围绕芯片设计迭代、新封装开发、集成器件开发等进行研发，全年研发费用 0.62 亿元，同比增长 10.10%，2025 年新获得发明专利 2 项，技术实力有所增强，但半导体

### 分立器件领域技术更迭较快，公司仍面临技术升级挑战

作为半导体分立器件制造商，跟踪期内，公司持续在半导体分立器件芯片设计、芯片制造、封装测试、产品应用等领域进行技术研发。截至 2025 年末，公司拥有研发人员 213 人，占公司总人数 15.85%，同比变动不大。2025 年，公司持续推进第三代半导体、智能功率模块、车规级器件等高端领域的研发工作，全年研发费用 0.62 亿元，同比增长 10.10%，占营业收入的比例为 5.88%；完成 6 英寸平面高速开关芯片批量量产，车用 SiC 功率器件研发取得阶段性突破，BLDC 电机驱动芯片已实现小批量订单。此外，公司新增申请发明专利 13 个，获得 2 个，新增申请实用新型专利 48 个，获得 24 个，截至 2025 年末，公司累计拥有有效专利 220 项，其中发明专利 42 项，实用新型专利 172 个，掌握高密度阵列式框架设计技术、点胶量 CPK 自动测量控制技术 etc 半导体分立器件封装测试技术，以及平面结构芯片无环高耐压终端技术、平面结构功率稳压二极管、TVS 芯片设计及制备技术等功率二极管芯片制造技术，并形成了多个在研项目<sup>2</sup>。

半导体分立器件领域技术更迭较快，近年沿着尺寸更小、功率密度更高的方向发展，在封测方面，第三、四代产品不断有新的封装出现，在多颗产品集成、功率增强等方面持续前进。目前在公司自主生产的产品中，封装形式主要集中在前三代，在高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力等方面与国际厂商相比仍存在技术差距。未来随着产品应用场景逐步拓展，下游客户对器件开关速度、工作电流、电压等的要求将越来越高，二极管、三极管产品的局部迭代不可避免，公司仍将面临技术升级挑战。

**公司采用以销定产为主的生产模式，跟踪期内，由于部分产线投产，产能有所提升，产量、产能利用率同比有所增长**

跟踪期内，公司仍采用“以销定产，柔性组织”的生产模式。2025 年，由于车规级半导体器件产业化项目等新增产线投产，公司产能有所提升；产量方面，2025 年，小信号器件及功率器件产量及产能利用率同比均有提升。

**图表 4：近年公司小信号及功率器件生产情况（百万只/年、百万只、%）**

	2023 年	2024 年	2025 年	
小信号器件	产能	9986.89	11420.66	13492.07
	产量	7089.83	9753.70	11754.28
	产能利用率	70.99	85.41	87.12
功率器件	产能	5822.83	6156.04	6383.42
	产量	3381.14	4397.31	4620.58
	产能利用率	58.07	71.43	72.38

资料来源：公司提供、东方金城整理

2025 年，下游终端市场产品景气度提升，公司积极调整产品结构、加大客户拓展力度，带动小信号器件、功率器件销量及销售收入同比增长，预计 2026 年，随着新能源汽车、5G 通信等新兴领域的需求增长及国产化替代加速，公司小信号器件、功率器件需求空间仍较为广阔

<sup>2</sup> 资料来源：公司《2025 年年报》。

2025年，下游终端市场产品景气度提升，公司重点提升MOS产品、TVS及稳压管产品的销售规模，在车规级半导体器件产业化项目方面，产销规模持续扩大。销售价格方面，小信号器件销售均价有所下降，功率器件销售均价同比提升。

受益于销量提升，小信号器件收入同比提升，但毛利率有所下滑；量价齐升带动功率器件销售收入、毛利率均同比增加。预计2026年，随着新能源汽车、网络通信、工业自动化等新兴领域的需求增长及国产化替代加速，公司小信号器件、功率器件需求空间仍较为广阔，将带动公司产品销售规模增长。

图表 5：近年公司小信号及功率器件销售情况

	2023年	2024年	2025年	
小信号器件	销量（百万只）	6925.60	9633.17	11824.19
	销售均价（元/千个）	47.78	41.56	35.57
	销售收入（亿元）	3.31	4.00	4.21
	毛利率（%）	31.66	30.76	26.91
功率器件	销量（百万只）	3370.04	4395.42	4656.97
	销售均价（元/千个）	94.08	100.48	116.09
	销售收入（亿元）	3.17	4.42	5.41
	毛利率（%）	21.26	24.67	25.22

资料来源：公司提供、东方金城整理

**跟踪期内，公司通过精准识别客户需求和提供定制化服务，提升客户满意度与忠诚度，前五大客户销售额占比同比变动不大**

公司涉及内销和外销销售。内销采用直销为主、经销为辅的营销模式。外销涵盖欧、美、日、韩等市场，以直销模式为主，2025年，公司外销收入占公司半导体元器件销售收入的比重为26.81%，同比增加2.11个百分点。在销售回款方面，部分客户会收取预收款，部分客户货到发货，一般会给予30~90天不等的账期。

跟踪期内，公司通过精准识别客户需求和提供定制化服务，提升客户满意度与忠诚度；并大客户建立长期合作关系，共同开展技术研发，以巩固公司在细分行业的市场地位。2025年，公司主要客户较为稳定，前五大客户销售额合计占年度销售总额比例24.25%，同比变动不大。

图表 6：2025 年公司前五大客户销售情况<sup>3</sup>（亿元、%）

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例
1	单位 1	0.64	6.13
2	单位 2	0.64	6.11
3	单位 3	0.52	4.94
4	单位 4	0.44	4.16
5	单位 5	0.31	2.91
合计		2.55	24.25

资料来源：公司提供、东方金城整理

跟踪期内，公司仍采用集中管理、分散采购的模式，采购原材料以芯片为主，采购整体仍较为分散

跟踪期内，材料成本占营业成本比重仍在 60%以上，主要原材料包括芯片、框架/引线、铜材、塑封料、包装材料、化工材料、硅片等，其中芯片占比最大；采购价格方面，2025 年芯片和框架/引线的采购均价同比均有所下降，铜材价格上升。公司仍采用“集中管理、分散采购”的模式，公司统一进行合格供应商管理，每年统一与供应商签订采购框架协议、质保协议等，各产品事业部根据生产计划需求及原材料库存进行采购，采购款一般按月结算，结算后有 60~90 天不等的账期。

跟踪期内，公司前五大供应商采购金额合计占采购总金额的比重为 24.80%，采购整体仍较为分散。

图表 7：2025 年公司前五大供应商<sup>4</sup>（亿元、%）

序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占比
1	单位 1	框架/引线、焊料	0.52	9.02
2	单位 2	芯片、模具及备件	0.33	5.67
3	单位 3	芯片	0.23	4.05
4	单位 4	框架/引线	0.19	3.20
5	单位 5	芯片	0.17	2.86
合计			1.43	24.80

资料来源：公司提供、东方金城整理

### 未来发展

公司主要在建项目为高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目，国产替代趋势下有助于公司业务规模扩大，但后续投资规模较大，若市场开拓不及预期、外部经济环境等方面发生较大不利变化，或面临一定产能消纳及投资回报不及预期的风险

跟踪期内，公司车规级半导体器件产业化项目已达预定可使用状态。截至 2026 年 3 月末，公司未来投资规模较大的主要在建项目包括高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目，项目计划总投资规模 3.10 亿元，已投资规模 0.88 亿元，仍需投资规模 2.22 亿元，后续投

<sup>3</sup> 为公司全部业务的前五大客户。

<sup>4</sup> 为公司全部业务的前五大供应商。

资规模较大。

公司为提高集成电路分立器件产品的生产加工制造能力，扩大集成电路分立器件产品的生产规模，计划以自有资金投资实施高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目，该项目预计通过购置土地及开展厂房土建工程，为后续高端集成电路分立器件产业化基地建设奠定基础，建设周期预计 30 个月。

未来在建项目完工投产后，预计公司生产能力将进一步增加，国产替代趋势下有助于业务规模提升，但在建项目未来投资规模仍较大，如未来市场开拓不及预期，或未来市场发生不利变化导致下游需求不及预期，或将面临一定产能消纳及投资回报不及预期的风险。

## 公司治理与战略

### 跟踪期内，公司在内部治理、发展战略方面无重大变化

公司治理方面，跟踪期内，公司对部分内部治理制度进行修订，更换董事 2 名，监事、高级管理人员无重大变化；组织结构方面无重大变化。

公司战略方面，公司将继续实施技术创新，专注于半导体分立器件行业做精做强，进一步拓宽产品种类，提升产品性能，提高产品档次；公司将继续推进结构调整，坚持纵向一体化发展战略，全面优化芯片和封测技术，增强生产柔性和效率，扩大经营规模；公司将继续坚持市场导向，提升市场营销能力，强化技术服务支撑，拓展国内外中高端市场领域，提升盈利能力。

公司秉承低碳经营的可持续发展理念，按照 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、IATF16949、IECQ QC080000 等国际标准建立管理体系，推进绿色产品制造。同时，公司导入碳管理体系、储能项目方案及业务连续性管理（BCM）体系，在生产过程中持续推进节能减排技术改造，优化生产工艺，降低能源消耗和污染物排放，提升资源利用效率；同时，积极布局储能等绿色产业，以实现可持续发展的战略目标。

## 财务分析

### 财务质量

公司提供了 2025 年审计报告及 2026 年 1~3 月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务数据进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2026 年 1~3 月财务报表未经审计。

截至 2025 年末，公司纳入合并范围的子公司共 7 家。

### 资产构成与质量

跟踪期内，公司资产规模有所增长，随着业务规模增加，应收账款、存货规模有所增长，对资金占用增加

跟踪期内，公司资产规模有所增长，资产结构仍以流动资产为主。

2025 年末，公司流动资产小幅下降，仍主要由交易性金融资产、应收账款、货币资金和存货等构成。交易性金融资产是公司购买的银行理财产品，规模变化不大。受销售增加及结算周期影响，应收账款规模有所增长，周转效率有所下降，2025 年末按欠款方归集的期末余额前五

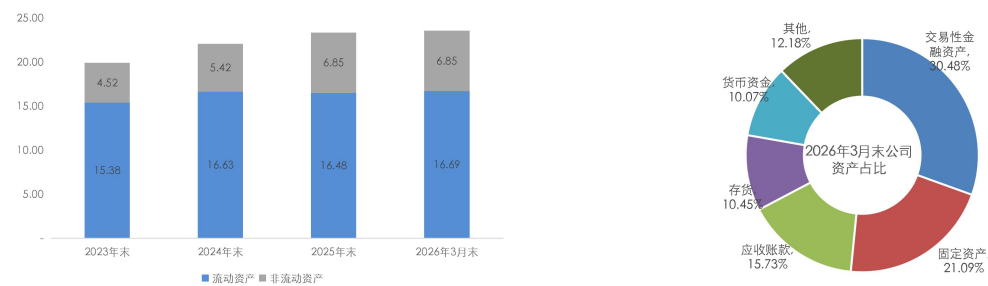
名的应收账款和合同资产期末余额合计占比 33.47%。截至 2025 年末，货币资金规模有所减少。公司存货主要为在产品、发出商品和原材料，跟踪期内随着业务规模增加，存货规模有所增长，且周转效率有所加快；截至 2025 年末，累计计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备 0.19 亿元。

随着公司工程项目持续投建以及无形资产的增加，跟踪期内非流动资产规模有所增长。截至 2025 年末，非流动资产主要由固定资产、无形资产和在建工程等构成。主要由于新增购置以及在建工程转入，固定资产规模有所增加。由于车规级半导体器件产业化项目持续投入，截至 2025 年末，公司在建工程规模小幅增加。同期，由于新增购置土地使用权，无形资产大幅增长。长期股权投资变动不大，其他权益工具投资同比减少 52.74%，主要由于 2025 年回购所投资企业股权所致。

截至 2025 年末，公司受限资产规模为 3530.41 万元；其中受限货币资金 275.67 万元，受限原因为“银行承兑汇票保证金”；受限应收票据 3234.17 万元，受限原因为“已背书或贴现未到期的应收票据未终止确认”；受限应收账款 20.57 万元，受限原因为“已背书或贴现未到期的数字债权凭证未终止确认”；合计占资产总额比重为 1.51%，占净资产比重为 2.50%。

截至 2026 年 3 月末，公司资产规模较 2025 年末变化不大，构成仍以流动资产为主，货币资金规模回升，在建工程有所减少。

图表 8：公司资产构成及质量情况（亿元）



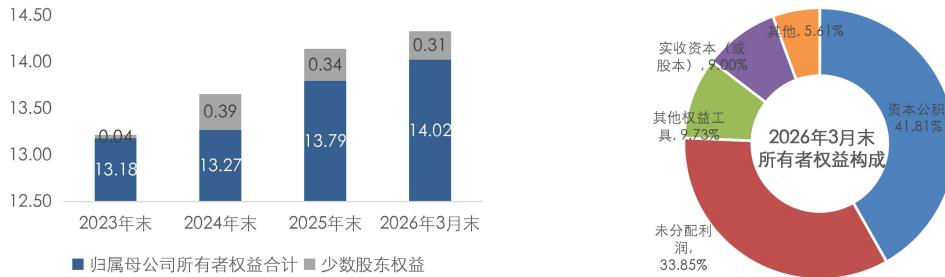
项目	2023 年末	2024 年末	2025 年末	2026 年 3 月末
交易性金融资产	7.54	7.92	7.97	7.18
应收账款	2.23	3.35	3.95	3.70
货币资金	2.80	2.47	1.37	2.37
存货	1.65	1.95	2.19	2.46
<b>流动资产合计</b>	<b>15.38</b>	<b>16.63</b>	<b>16.48</b>	<b>16.69</b>
固定资产	3.75	3.74	4.42	4.96
在建工程	0.16	0.75	0.89	0.34
无形资产	0.21	0.19	0.97	0.96
长期股权投资	0.06	0.32	0.31	0.30
其他权益工具投资	0.25	0.25	0.12	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>4.52</b>	<b>5.42</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>
<b>资产总额</b>	<b>19.90</b>	<b>22.06</b>	<b>23.34</b>	<b>23.54</b>

资料来源：公司提供，东方金城整理

## 资本结构

受益于经营积累，跟踪期内公司所有者权益保持增长，资本公积和未分配利润占比仍较高。主要受益于经营积累，跟踪期内所有者权益规模保持增长，构成主要包括资本公积、未分配利润、其他权益工具、股本等构成。跟踪期内，由于回购所投资企业股权，其他综合收益有所减少；受益于经营积累，未分配利润保持增长。

图表 9：公司所有者权益情况（亿元）



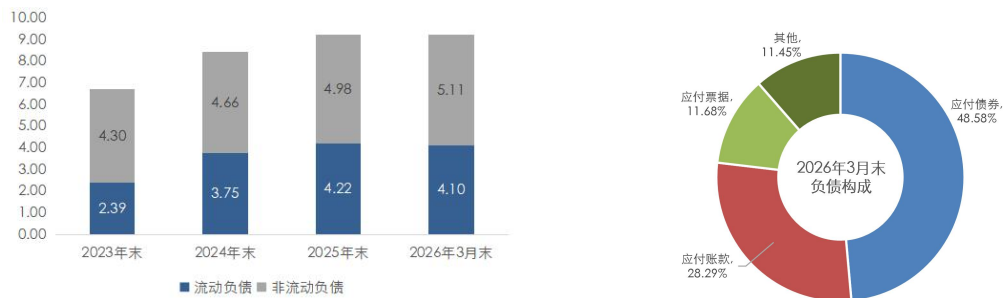
资料来源：公司提供，东方金城整理

## 跟踪期内，公司债务规模有所增长，债务构成以存续债券“银微转债”为主

跟踪期内，公司负债总额有所增长，仍主要由应付债券、应付账款和应付票据等构成。

跟踪期内，公司流动负债有所增长，主要由于原料采购增加，应付账款及应付票据规模均有所增长，其中账龄 1 年以内（含 1 年）应付账款的占比为 98.55%。非流动负债仍主要由应付债券等构成，由于“银微转债”按面值计提利息及溢折价摊销，应付债券规模有所增长，带动非流动负债规模增长。

图表 10：公司负债情况（亿元）



项目	2023 年末	2024 年末	2025 年末	2026 年 3 月末
应付账款	1.57	2.45	2.69	2.61
应付票据	0.52	0.85	1.07	1.08
流动负债合计	2.39	3.75	4.22	4.10
应付债券	3.73	4.05	4.37	4.47
非流动负债合计	4.30	4.66	4.98	5.11
负债总额	6.69	8.40	9.20	9.21

资料来源：公司提供，东方金城整理

全部债务方面，跟踪期内，由于“银微转债”按面值计提利息及溢折价摊销带动应付债券规模增长以及应付票据规模增加，公司全部债务规模增幅较大。截至2026年3月末，公司全部债务5.75亿元，包括“银微转债”、应付票据、银行借款及租赁负债，其中短期债务和长期债务占比分别为22.15%和77.85%。跟踪期内，公司资产负债率、长期债务资本化比率、全部债务资本化比率均有所增长。

图表 11：公司债务情况（亿元）



资料来源：公司提供，东方金城整理

对外担保方面，截至2026年3月末，公司无对外担保。

## 盈利能力

### 2025年，公司整体产销提升，营业收入同比增长，盈利能力仍有所提升

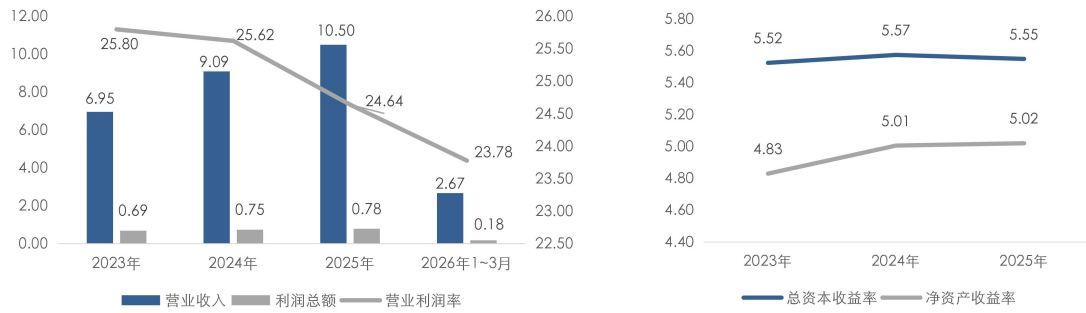
2025年，下游终端市场产品景气度提升，公司加大客户拓展力度，整体产销提升，全年实现营业收入10.50亿元，同比增长15.46%；同期，营业利润率24.64%，同比小幅下降。2025年，随着业务规模扩大、研发投入增加、利息费用增多，期间费用规模有所扩大，但期间费用率有所下降。

2025年，公司非经营性收益主要是其他收益与公允价值变动收益，非经营性损失主要是资产减值损失；由于进项税加计抵减金额回落，其他收益同比减少；公允价值变动损益仍为交易性金融资产公允价值变动产生，同比减少29.02%；资产减值损失同比变动不大，仍主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。

由于主营业务获利规模增加，2025年公司实现利润总额0.78亿元，同比增加4.86%。同期，公司总资本收益率和净资产收益率变动不大。

2026年1~3月，公司实现营业收入2.67亿元，同比增长22.48%；营业利润率23.78%，同比变动不大；实现利润总额0.18亿元。

图表 12：公司盈利能力情况（亿元、%）



资料来源：公司提供，东方金城整理

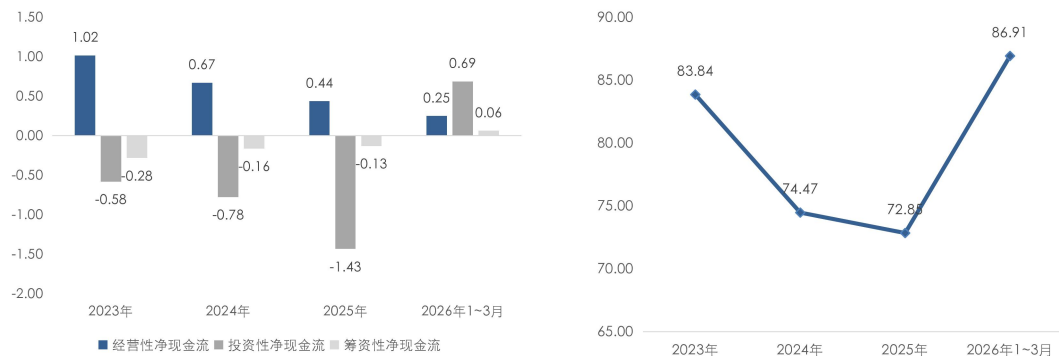
### 现金流

跟踪期内，应收账款及存货对资金占用增加，经营性现金净流入规模同比降幅较大，投资活动现金流持续净流出，筹资活动产生的现金流规模不大

2025年，由于应收账款及存货对资金占用增加，经营性现金流净流入规模同比降幅较大。同期，现金收入比为86.91%，同比大幅回升。

公司投资活动现金流入主要为收回的理财产品投资资金；投资活动现金流出主要为购买理财产品支出资金以及购建固定资产等支付的现金；跟踪期内，受购建固定资产支出影响，投资活动现金流持续净流出。筹资活动方面，2025年，公司筹资活动产生的现金流入、流出规模均较小。

图表 13：公司现金流情况（亿元、%）



资料来源：公司提供，东方金城整理

### 偿债能力

从短期偿债能力指标来看，跟踪期内，公司流动比率和速动比率均有所下降，经营性净现金流对流动负债的覆盖程度有所减弱，EBITDA对利息的覆盖程度有所提升，对全部债务的覆盖程度有所下降。

截至2026年3月末，公司短期债务为1.27亿元；截至本报告出具日，公司无未来一年到期的债券（含回售）。2025年公司经营性净现金流为0.44亿元，投资性净现金流为-1.43亿元，筹资活动前净现金流为-0.99亿元。预计2026年，随着新能源汽车、网络通信、工业自动化等新兴领域的需求增长及国产化替代加速，公司小信号器件、功率器件需求空间仍较为广阔，将

带动公司产品销售规模增长，“车规级半导体器件产业化项目”仍将保持一定规模的资本支出，预计筹资活动前净现金流对短期债务的保障能力仍较弱。

公司融资渠道畅通，截至 2026 年 3 月末，公司合并口径的银行授信总额 5.20 亿元，未使用额度 3.93 亿元，具有一定备用流动性。

图表 14：公司偿债能力主要指标（%、倍）

指标名称	2023 年 (末)	2024 年 (末)	2025 年 (末)	2026 年 3 月 (末)
流动比率	644.76	443.90	390.82	406.67
速动比率	575.39	391.84	339.01	346.70
经营现金流动负债比	42.61	17.89	10.37	-
EBITDA 利息倍数	4.73	4.83	4.95	-
全部债务/EBITDA	2.76	2.90	2.93	-

资料来源：公司提供，东方金诚整理

### 过往期债务履约和其他信用记录

根据公司提供的、由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》（自主查询版），截至 2026 年 5 月 7 日，公司本部未结清贷款中不存在关注及不良类记录。

截至本报告出具日，“银微转债”按时支付利息，尚未到还本日。

### 抗风险能力及结论

公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售，具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力，跟踪期内仍具有一定细分市场竞争力；研发方面公司完成 6 英寸平面高速开关芯片批量量产，车用 SiC 功率器件研发取得阶段性突破，2025 年新获得发明专利 2 项，研发费用 0.62 亿元，同比增加 10.10%，仍保持较强技术实力；公司围绕汽车电子、储能等行业，加大大客户开发力度，导入天马微、安斯泰莫、南都电源等客户，进入沃尔沃亚太国产白名单，巩固了在汽车电子领域市场地位；2025 年，下游终端市场产品景气度提升，公司 MOS 产品、TVS 及稳压管产品销售规模扩大，同时在车规级半导体产业化项目推进下，车规级产品产销规模持续扩大，带动营业收入及毛利润增长。

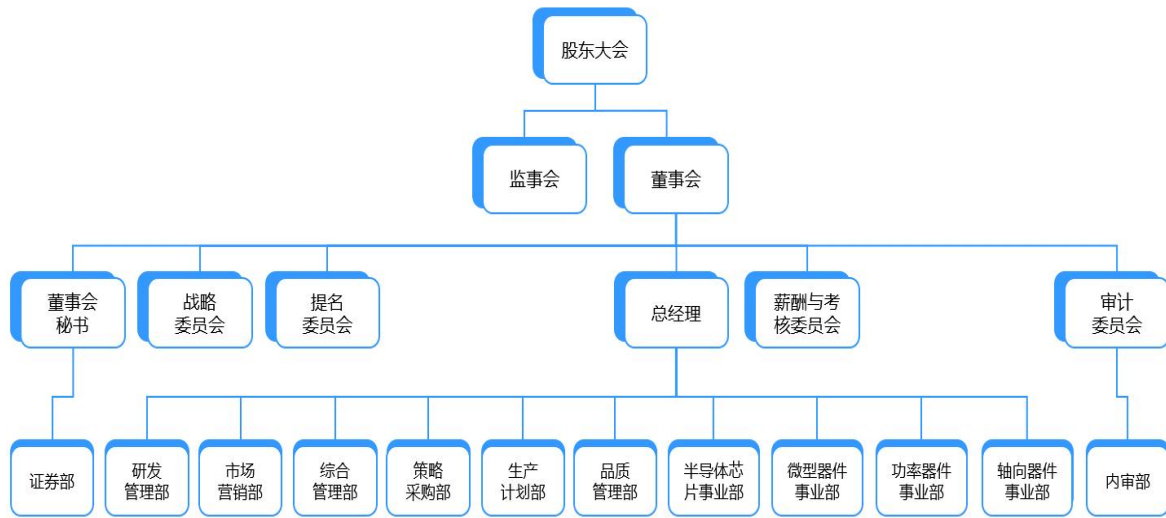
但同时，半导体分立器件领域技术更迭较快，下游客户需求不断升级、行业产品迭代仍将使公司面临技术升级挑战；2025 年，应收账款及存货对资金占用增加，经营性现金流净流入规模有所下降；2025 年末，公司在建项目后续投资规模仍较大，外部环境变化或将使公司面临投资回报不及预期的风险。

综合分析，东方金诚维持公司主体信用等级为 A<sup>+</sup><sub>st1</sub>，评级展望为稳定，维持“银微转债”的信用等级为 A<sup>+</sup><sub>st1</sub>。

附件一：截至 2026 年 3 月末公司股权结构图



附件二：截至 2026 年 3 月末公司组织结构图



附件三：银河微电主要财务数据和财务指标

项目名称	2023年	2024年	2025年	2026年3月
<b>主要财务数据及指标</b>				
资产总额 (亿元)	19.90	22.06	23.34	23.54
所有者权益 (亿元)	13.21	13.65	14.14	14.33
负债总额 (亿元)	6.69	8.40	9.20	9.21
短期债务 (亿元)	0.54	0.93	1.24	1.27
长期债务 (亿元)	3.75	4.06	4.38	4.48
全部债务 (亿元)	4.29	4.99	5.61	5.75
营业收入 (亿元)	6.95	9.09	10.50	2.67
利润总额 (亿元)	0.69	0.75	0.78	0.18
净利润 (亿元)	0.64	0.68	0.71	0.15
EBITDA (亿元)	1.55	1.72	1.91	-
经营活动产生的现金流量净额 (亿元)	1.02	0.67	0.44	0.25
投资活动产生的现金流量净额 (亿元)	-0.58	-0.78	-1.43	0.69
筹资活动产生的现金流量净额 (亿元)	-0.28	-0.16	-0.13	0.06
毛利率 (%)	26.49	26.22	25.14	24.49
营业利润率 (%)	25.80	25.62	24.64	23.78
销售净利率 (%)	9.18	7.52	6.76	5.50
总资本收益率 (%)	5.52	5.57	5.55	-
净资产收益率 (%)	4.83	5.01	5.02	-
总资产收益率 (%)	3.21	3.10	3.04	-
资产负债率 (%)	33.60	38.10	39.42	39.13
长期债务资本化比率 (%)	22.10	22.93	23.64	23.80
全部债务资本化比率 (%)	24.49	26.76	28.42	28.63
货币资金/短期债务 (%)	520.48	266.43	110.56	186.07
非筹资性现金净流量债务比率 (%)	10.12	-2.15	-17.76	16.27
流动比率 (%)	644.76	443.90	390.82	406.67
速动比率 (%)	575.39	391.84	339.01	346.70
经营现金流动负债比 (%)	42.61	17.89	10.37	-
EBITDA 利息倍数 (倍)	4.73	4.83	4.95	-
全部债务/EBITDA (倍)	2.76	2.90	2.93	-
应收账款周转率 (次)	-	3.26	2.88	-
销售债权周转率 (次)	-	2.99	2.61	-
存货周转率 (次)	-	3.72	3.80	-
总资产周转率 (次)	-	0.43	0.46	-
现金收入比 (%)	83.84	74.47	72.85	86.91

## 附件四：主要财务指标计算公式

指标	计算公式
毛利率 (%)	$(\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入} \times 100\%$
营业利润率 (%)	$(\text{营业收入} - \text{营业成本} - \text{税金及附加}) / \text{营业收入} \times 100\%$
销售净利率 (%)	$\text{净利润} / \text{营业收入} \times 100\%$
净资产收益率 (%)	$\text{净利润} / \text{所有者权益} \times 100\%$
总资本收益率 (%)	$(\text{净利润} + \text{利息费用}) / (\text{所有者权益} + \text{长期债务} + \text{短期债务}) \times 100\%$
总资产收益率 (%)	$\text{净利润} / \text{资产总额} \times 100\%$
资产负债率 (%)	$\text{负债总额} / \text{资产总额} \times 100\%$
长期债务资本化比率 (%)	$\text{长期债务} / (\text{长期债务} + \text{所有者权益}) \times 100\%$
全部债务资本化比率 (%)	$\text{全部债务} / (\text{长期债务} + \text{短期债务} + \text{所有者权益}) \times 100\%$
担保比率 (%)	$\text{担保余额} / \text{所有者权益} \times 100\%$
EBITDA 利息倍数 (倍)	$\text{EBITDA} / \text{利息支出}$
全部债务/EBITDA (倍)	$\text{全部债务} / \text{EBITDA}$
货币资金/短期债务 (倍)	$\text{货币资金} / \text{短期债务}$
非筹资性现金净流量债务比率 (%)	$(\text{经营活动产生的现金流量净额} + \text{投资活动产生的现金流量净额}) / \text{全部债务} \times 100\%$
流动比率 (%)	$\text{流动资产合计} / \text{流动负债合计} \times 100\%$
速动比率 (%)	$(\text{流动资产合计} - \text{存货}) / \text{流动负债合计} \times 100\%$
经营现金流动负债比率 (%)	$\text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{流动负债合计} \times 100\%$
应收账款周转率 (次)	$\text{营业收入} / \text{平均应收账款净额}$
销售债权周转率 (次)	$\text{营业收入} / (\text{平均应收账款净额} + \text{平均应收票据})$
存货周转率 (次)	$\text{营业成本} / \text{平均存货净额}$
总资产周转率 (次)	$\text{营业收入} / \text{平均资产总额}$
现金收入比率 (%)	$\text{销售商品、提供劳务收到的现金} / \text{营业收入} \times 100\%$

注：EBITDA=利润总额+利息费用+折旧+摊销

长期债务=长期借款+应付债券+租赁负债+其他长期债务

短期债务=短期借款+交易性金融负债+一年内到期的非流动负债+应付票据+其他短期债务

全部债务=长期债务+短期债务

利息支出=利息费用+资本化利息支出

## 附件五：信用等级符号及定义

### 主体及中长期债券信用等级符号及定义

等级符号	定义
AAA	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
AA	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
A	偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低
BBB	偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般
BB	偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险
B	偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高
CCC	偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高
CC	在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务
C	不能偿还债务

注：除AAA级和CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

### 科技创新主体信用等级符号及定义

等级符号	定义
AAA <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
AA <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
A <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低
BBB <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般
BB <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险
B <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高
CCC <sub>sti</sub>	偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高
CC <sub>sti</sub>	在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务
C <sub>sti</sub>	不能偿还债务

注：除AAA<sub>sti</sub>级和CCC<sub>sti</sub>级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

### 中长期科技创新债券信用等级符号及定义

等级符号	定义
AAA <sub>sti</sub>	科技创新债券安全性很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
AA <sub>sti</sub>	科技创新债券安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
A <sub>sti</sub>	科技创新债券安全性较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低
BBB <sub>sti</sub>	科技创新债券安全性一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般
BB <sub>sti</sub>	科技创新债券安全性较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险
B <sub>sti</sub>	科技创新债券较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高
CCC <sub>sti</sub>	科技创新债券安全性极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高
CC <sub>sti</sub>	在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还科技创新债券
C <sub>sti</sub>	不能偿还科技创新债券

注：除AAA<sub>sti</sub>级和CCC<sub>sti</sub>级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

### 短期债券信用等级符号及定义

等级符号	定义
A-1	还本付息能力最强，安全性最高
A-2	还本付息能力较强，安全性较高
A-3	还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响
B	还本付息能力较低，有一定的违约风险
C	还本付息能力很低，违约风险较高
D	不能按期还本付息

注：每一个信用等级均不进行微调。

### 短期科技创新债券信用等级符号及定义

等级符号	定义
A-1 <sub>sti</sub>	短期科技创新债券还本付息能力最强，安全性最高
A-2 <sub>sti</sub>	短期科技创新债券还本付息能力较强，安全性较高
A-3 <sub>sti</sub>	短期科技创新债券还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响
B <sub>sti</sub>	短期科技创新债券还本付息能力较低，有一定的违约风险
C <sub>sti</sub>	短期科技创新债券还本付息能力很低，违约风险较高
D <sub>sti</sub>	短期科技创新债券不能按期还本付息

注：每一个信用等级均不进行微调。